

中信建投证券股份有限公司
关于北京燕东微电子股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-56051430 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：田东阁	联系方式：010-86451640 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 泰康集团大厦 11 层

重大事项提示

2026 年 1-6 月，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）实现营业收入 97,851.98 万元，较上年同期增长 48.50%；基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均出现同比下降；归属于上市公司股东的净利润为-43,456.67 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-53,901.21 万元，处于亏损状态。

本期主要会计数据波动系：公司制造服务板块持续加大市场开拓力度，收入同比增长明显；同时，公司期间费用同比增长明显，导致归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润同比下降；其中 2026 年上半年研发费用同比增长 44.36%，系公司持续加大研发投入，扩充研发人员，并积极推动新工艺技术平台开发所致；销售费用同比增长 43.46%，系公司人员增长所致。2026 年 1-6 月，公司生产经营正常，不存在重大风险。

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕1304 号文”批准，燕东微向特定对象发行人民币普通股（A 股）225,083,986 股，每股面值 1 元。本次公司发行股票的发行价格为 17.86 元/股，募集资金总额为 402,000.00 万元，扣除发行费用 1,492.26 万元，实际募集资金净额为 400,507.73 万元。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐人、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人、保荐代表人已协助、督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，并确保公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均已明确知晓其在相关规则下的各项义务。
2	保荐人、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐人、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐人、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐人、保荐代表人已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；已对上市公司信息披露公告文件的制作提供必要指导和协助，并确保内容简明易懂、语言浅白平实、具有可理解性；已督促公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或协助公司隐瞒重要信息。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐人、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐人和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	保荐人、保荐代表人已督促相关主体对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等进行充分信息披露；已持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促其及时、充分履行承诺；未发现上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项存在不符合法律法规及其他相关规定的情形。
4	保荐人、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人、保荐代表人已督促上市公司建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度，积极回报投资者。

序号	工作内容	持续督导情况
5	保荐人、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。保荐人、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐人、保荐代表人应当发表意见予以说明。	保荐人、保荐代表人已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；已通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况；本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐人、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	在本持续督导期间，上市公司股票未出现严重异常波动。
7	保荐人、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐人、保荐代表人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，前述主体在本持续督导年度内未减持公司股份。
8	保荐人、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人、保荐代表人已持续关注上市公司募集资金使用情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人、保荐代表人已查阅公司建立的信息披露制度，并对信息披露文件进行了事前审阅，确认上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在公司不予更正或补充，应及时向上海证券交易所报告的情形。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2026 年上半年，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、伤害证券交易所纪律处分或者被出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及	2026 年上半年，上市公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
	时向上海证券交易所报告。	
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2026 年上半年，上市公司不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2026 年上半年，上市公司未发生相关情形。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2026 年上半年，上市公司未出现相关情形。保荐代表人已制定现场检查工作计划，将持续确保现场检查工作质量。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2026 年上半年，上市公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）行业周期性及公司经营业绩波动风险

半导体行业周期性波动特征明显。如果下游消费电子等主要应用领域需求发生较大周期性调整，叠加市场竞争加剧或公司未能及时捕捉需求变化、产线运营效率出现波动，可能面临产品价格下行及销售承压等局面，对公司收入持续增长形成一定挑战。

（二）客户集中度较高的风险

公司客户相对集中，如果未来主要客户发生重大经营不利变化或调整采购策略，公司订单稳定性将面临挑战，可能对公司收入及利润水平产生负面影响。

（三）主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司依赖上游原材料及时供应以保障产线稳定运行。如果未来主要供应商因产能不足、价格策略调整或外部突发因素，发生供货周期延长、成本上升甚至供应中断等情形，公司可能面临阶段性供应紧张或成本压力加大的风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。

（四）核心技术泄密风险

公司核心技术及持续创新能力是参与行业竞争的重要基础。公司在长期发展中积累了较为完善的专利与非专利技术体系，是保障产品竞争力与制造服务能力的核心依托。如果公司核心技术发生失密或被侵权使用，可能导致公司主要业务的市场竞争力受损，进而对公司经营发展形成不利影响。

（五）核心竞争力风险

结合半导体行业强周期波动、产品技术迭代速度快的行业特性，公司核心竞争力层面主要存在两类风险：

一是产线投资建设风险。新建产线建设周期长、资本开支规模大，若项目推进滞后、产能投产释放不及规划，或是量产工艺指标未达预期标准，将直接制约产品交付保障能力、弱化市场竞争优势，最终对整体经营效益形成负面冲击。

二是客户市场营销风险。下游客户需求存在动态调整特征，若发生外部环境变化、需求研判偏离、客户响应滞后等情况或将引发核心客户流失，造成市场份额萎缩，拖累经营业绩表现。

（六）行业风险

当前晶圆代工行业格局高度分化，先进制程产能维持紧缺，成熟制程则呈现大规模扩产、竞争持续加剧的特点。成熟制程虽阶段性出现晶圆代工涨价行情，但行业集中扩产或将导致远期产能过剩风险持续累积。此外，叠加行业周期轮换、应用端需求迭代等诸多重要因素，将对公司中长期盈利水平、市场份额及产品定价权形成持续考验，公司相较行业头部企业仍存在明显差距。

（七）宏观环境风险

公司面临的半导体产业宏观环境风险，主要集中于宏观需求传导、国际贸易管制及行业投资波动三大维度。全球经济增速整体放缓，叠加国际贸易壁垒、限制性政策持续增多，对半导体产业链进出口贸易及整体供应链的稳定性、安全性形成持续冲击。与此同时，地缘关系持续趋紧，技术与设备出口管制不断升级，导致公司设备采购、核心技术迭代升级受限，一定程度上制约公司战略发展落地与核心竞争力提升。此外，公司优质客户的订单或受宏观政策、预算调整等因素影响，造成核心业务订单稳定性不足，进一步放大宏观环境波动带来的各类经营风险。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，燕东微不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	978,519,764.57	658,941,289.28	48.50
归属于上市公司股东的净利润	-434,566,672.33	127,605,338.40	-440.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-539,012,060.12	-389,844,713.50	/
经营活动产生的现金流量净额	-224,223,809.79	221,152,782.81	-201.39
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 6 月末	本期末比上年度 末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	18,111,382,830.45	18,330,351,381.47	-1.19

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
总资产	45,357,154,787.92	37,090,872,201.23	22.29

公司主要财务指标如下表所示：

单位：元

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.11	-372.73
稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.11	-372.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.32	/
加权平均净资产收益率（%）	-2.39	0.86	减少 3.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.96	-2.64	减少 0.32 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	53.70	55.24	减少 1.54 个百分点

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

报告期内，公司营业收入同比增长 48.50%，主要系公司制造服务板块持续加大市场开拓力度所致；归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系公司研发投入增加，此外非经营性损益投资收益下降所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系公司收到的税费返还减少、支付职工的现金增加所致；基本每股收益以及稀释每股收益同比下降，主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）深耕战略合作布局，强化市场竞争力

公司持续深耕高端市场客户开拓与生态战略合作，稳步夯实产业核心竞争优势。各所属公司战略合作客户持续增加，其中，北电集成导入多家客户；燕东科技拓展战略客户及新客户突破 20 家；此外，客户结构持续向头部优质资源优化升级。公司聚焦硅光核心赛道，持续深化产业协同合作，新增多家行业核心战略合作伙伴，顺利达成深度合作共识并形成批量订单。通过精准市场布局、长效战略合作绑定，持续强化市场竞争力水平。

（二）突破硅光核心工艺，夯实平台产业化能力

公司硅光工艺平台建设与技术研发工作稳步推进、成效显著。其中，8 英寸 SiN 平台通过自主工艺研发实现关键性能指标突破，传输损耗性能达到行业量产先进水平。12 英寸 SOI 工艺平台建设进度持续加快，重点围绕低损耗波导、高速调制器、光电探测器等核心工艺模块开展攻坚研发，各项研发工作均严格按照既定节点有序推进。同时，公司积极联动战略客户，深度对接产业化需求，全力加速技术成果落地转化。此外，公司持续加大硅光领域专业技术人才引入力度，不断夯实核心研发团队实力，进一步筑牢技术研发与创新根基，稳步提升公司硅光工艺平台整体核心竞争力。

（三）持续加大研发投入，筑牢自主技术根基

公司深耕半导体近四十年，始终坚持创新驱动发展战略，立足自研核心技术底座，搭建覆盖多品类芯片的工艺平台体系。2026 年上半年研发投入 5.25 亿元，研发投入占营业收入 53.70%，同比增加 44.36%。其中，硅光平台 Si/SiN 波导损耗关键性能达到业内先进水平，12 英寸 SOI 研发顺利。功率平台产品定型超过 50 款，8 英寸 IGBT 完成开发；逻辑平台 12 英寸 150HV 平台定型。此外，多措并举引育研发团队，截至 2026 年 6 月 30 日公司研发人员达 647 人。报告期内，公司新增专利申请 49 件，新增授权专利 18 件，知识产权布局持续提速。

（四）聚力数据赋能，助力经营提质与效能提升

公司坚持数据驱动、技术赋能主线，统筹推进流程建设、智能化生产、精细化运营、体系保障四大板块，全面推动晶圆制造业数字化、网络化、智能化转型。截至上半年，燕东科技 8 英寸产线月均产出超 6 万片，8/12 英寸产线良率达到 90%以上。依托数字化工具重构业务流程，打通数据壁垒实现全域数据互通；落地智能生产技术改造，以自动化、数字化手段提质增效；以 ERP 系统为核算链路搭建精细化运营数字管控平台，实现经营全链路可视可管可控；同步完善信息安全、运维管理等配套保障体系，以数字化赋能打造企业长期竞争优势。

七、研发支出变化及研发进展

（一）报告期内获得的研发成果

1、基于北电集成 12 英寸集成电路生产线项目，开展核心工艺开发与关键技

术攻坚工作，完成三大工艺平台的全流程开发，推进客户资源导入，夯实产品规模化量产基础。

2、燕东科技 12 英寸生产线，丰富工艺平台，加速技术迭代，推动产能释放，实现技术与产业协同发展。其中：

（1）SOI 硅光工艺平台：在 SOI 平台上实现低损耗 SiN 波导的异质集成，传输损耗达到行业领先水平，与行业头部企业开展深度合作，加速量产进程；

（2）CMOS 工艺平台：完成 0.18um CMOS 工艺平台全流程通线及关键工艺固化，参数指标性能达到业界主流水平，导入多家客户产品开展验证工作，加速推进商业化进程；

（3）HV CMOS 工艺平台：完成 0.15um HV CMOS 工艺平台全流程开发及关键工艺固化，推进多客户导入验证工作；完成 0.11um HV CMOS 工艺平台 OPC 建模和首款产品制版工作，加速推进关键工艺开发及产品流片；

（4）功率器件工艺平台：持续丰富 Trench MOS、SGT 等工艺平台产品型号，导入并定型新产品数十款。

3、燕东科技 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，加速产品结构调整，实现产能与效益提升，其中：

（1）SiN 硅光工艺平台：加速产能释放，产品在光模块头部企业实现规模化应用；平台良率和交付能力持续提升；

（2）BCD 工艺平台：0.35um 600V BCD 平台完成超高压电平转换器件、超高压场效应晶体管结构优化，发布 PDK1.0 版本；

（3）功率器件工艺平台：4500V Planar IGBT 工艺平台完成代表产品试制，通过可靠性评测，SGT 工艺平台持续丰富电压节点，拓展产品品类，导入并定型新产品数十款。

4、基于 6 英寸 Si/SiC 生产线，持续提升工艺能力，加速丰富器件类型，其中：

（1）SiC 基工艺平台：1200V 20m Ω SiC MOS 器件通过验证；650V/1200V

SiC SBD 产品实现系列化和量产交付；

(2) Si 基工艺平台：1700V/2300V 超高压 RC IGBT 产品通过验证；车规级低压大电流 MOS 产品实现系列化和量产。

5、产品解决方案方面，基于自身设计工艺，实现以下系列产品开发与量产，其中：

(1) 完成两款信号链和功率 SIP 产品开发，通过用户试用；

(2) 基于 SOI-CMOS 工艺平台开发 ACS 系列产品，通过可靠性评估，满足用户指标要求。

(二) 报告期内获得的知识产权列表

项目	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	12	0	232	111
实用新型专利	37	18	438	369
外观设计专利	0	0	0	5
软件著作权	0	0	19	18
其他	1	21	94	81
合计	50	39	783	584

(三) 研发投入情况表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	525,496,603.50	364,013,289.44	44.36
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	525,496,603.50	364,013,289.44	44.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	53.70	55.24	减少 1.54 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

报告期内，公司研发投入同比增长 44.36%，主要系公司高度重视产品研发及技术创新，通过扩充研发人员，并积极推动新工艺技术的开发平台所致。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	395,344.63
其中：超募资金金额	-
减：各项发行费用（不含增值税）	19,693.29
二、募集资金净额	375,651.34
减：	
募投项目以前年度已使用金额	134,970.51
募投项目本年度使用金额	-
募投项目先期投入置换金额	165,395.57
以前年度补充流动资金金额	77,039.40
本年度补充流动资金金额	11.59
现金管理净额	1,600.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
加：	
募集资金利息收入	2,573.89
现金管理收益	3,272.26
三、报告期期末募集资金余额	2,480.27

（二）向特定对象发行股票

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	402,000.00
其中：超募资金金额	-
减：各项发行费用（不含增值税）	1,492.26
二、募集资金净额	400,507.73
减：	
募投项目以前年度已使用金额	121,046.73
募投项目本年度使用金额	93,363.85

项目	金额
募投项目先期投入置换金额	80,000.00
以前年度补充流动资金金额	-
本年度补充流动资金金额	78.30
现金管理净额	80,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.66
加：	
募集资金利息收入	336.11
现金管理收益	2,391.10
三、报告期期末募集资金余额	28,744.41

公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	名称	角色	直接持股数量（股）	直接持股比例
1	北京电子控股有限责任公司	控股股东、实际控制人	645,657,112	45.23%
2	刘锋	总裁、副董事长	150,000	0.01%
3	旷炎军	董事	150,000	0.01%
4	霍凤祥	执行副总裁、董事会秘书	120,000	0.01%
5	滕彦斌	财务总监	120,000	0.01%
6	周贺	执行副总裁	120,000	0.01%

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

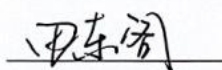
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张 林



田东阁

中信建投证券股份有限公司

2026 年 8 月 24 日

